

第49 回ソルダリング分科会プログラム

日時:平成22 年 7月 2日(金) 10:30～16:30

場所:自動車会館 大会議室(東京都千代田区)

主 題 「次世代ソルダリング技術・品質の新たな展開」

時 間	題 目	講 演 者
平成 22 年 7 月 2 日 金 曜 日	司会 西川 宏 (大阪大学)	
	『耐エレクトロマイグレーション特性に 優れるはんだ接続部の開発』 (45 分)	日立金属(株) 冶金研究所 ○藤吉 優、千綿伸彦 日立金属(株) 安来工場 若野基樹 (株)日立製作所 機械研究所 谷江尚史
	『Sn-Ag-Cu 三元系鉛フリーはんだの 凝固過程の解析』 (45 分)	防衛大学校 機能材料工学科 ○江阪久雄、鷹松喜子 篠塚 計
	12:00～ 13:00	昼 食 休 憩
	13:00～ 13:10	分 科 会 議 事
	司会 山部 光治 (株東芝)	
	『BGA パッケージはんだ接合部の 熱疲労寿命についての考察』 (45 分)	(株)東レリサーチセンター ○伊藤元剛、的場伸啓 平野孝行、三橋和成
	『Sn-Sb 系はんだ材料の迅速疲労試験』 (45 分)	ニホンハンダ(株)開発部 ○浅黄 剛、三谷 進
	14:40～ 15:00	休憩
	司会 宮崎 誠 (長野沖電気(株))	
15:00～ 16:30	『実装はんだウイスカの評価試験』 (45 分)	エスベック(株) ○鈴木 聡、小林晶子 戸井恵子、梶原隆志 鈴木智也、竹内 誠 高橋邦明
	『検査機を活用した新たな実装品質の展開』 (45 分)	オムロン(株) ○平岡義明

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。